

超小型模块

世界最小尺寸的 Bluetooth® 4.0 Smart Module 开始量产

- 最适合可穿戴设备的世界最小*尺寸 4.6 x 5.6 x 1.0mm (TYP)
- 可轻松地与 Bluetooth® Smart Ready 兼容产品进行通信
- 以天线分离式扩大了产品设计的自由度

2014 年 2 月 12 日

TDK 株式会社（社长：上釜 健宏）开发出最适合于今后将会迅速普及的可穿戴设备的超小型 Bluetooth® 模块（产品名：SESUB-PAN-T2541），并将从 2014 年 2 月起开始量产。

该产品采用敝社自有的 IC 内置基板（SESUB），将 Bluetooth® IC 内置于基板内，并将晶体振荡器、带通滤波器、电容器等配套电路元件贴装在基板上，从而实现了世界最小*尺寸（4.6 x 5.6 x 1.0mm）的 Bluetooth® 4.0 Smart 模块。该尺寸与分立式相比，节省了 64% 的基板占有面积。

取代智能手机，现在受到世人瞩目的是眼镜型、手表型等可穿戴设备。可穿戴设备被用于与智能手机、平板电脑、个人计算机等进行无线通信，而该无线通信使用的就是 Bluetooth®。该产品由于支持 Bluetooth® 最新标准——Bluetooth® 4.0 Smart（别名 Bluetooth® Low Energy），其耗电仅为以往 Bluetooth® 的约 1/4，是低功耗产品。使用于电池驱动，是最适合于要求小型、轻巧与低功耗的可穿戴设备的模块。

* 截止到 2014 年 2 月，TDK 调查

主要应用

- 保健、体育&健身设备（活动量计、体温计、血压计、血糖仪、心率表等）
- 可穿戴电脑（腕带型、手表型、眼镜型、鞋子、帽子、衬衫等）
- 家电&娱乐设备（遥控器、传感标签、玩具、灯具等）
- PC 配件（鼠标、键盘、演讲激光笔等）

主要特点和优势

- 为超小型模块（26mm²），大幅减少了实装面积
- 仅需连接电源和天线就可进行 Bluetooth® 通信
- 可确保无线性能的模块，降低了硬件设计者的设计负担
- 具备了分立式 IC 上的所有端子，可以全面活用 IC 的功能

主要电气特性

- 通信标准: 2.4GHz Bluetooth® V4.0 low energy
- 无线输出: 0dBm (typ)
- 通信距离: 10m (预估距离。取决于天线特性。)
- 接口 : UART / SPI / I2C / GPIO / ADC

Bluetooth®, Bluetooth® low energy 是由 Bluetooth Special Interest Group (SIG) 所规定的标准。

关于 TDK 公司

TDK 株式会社是一家领先的电子公司，总部位于日本东京。公司成立于 1935 年，主营铁氧体，是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK 的主要产品线包括 TDK 和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件，模块和系统产品*；电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK 以成为电子元件的领先企业为目标，重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2013 年度 3 月末，TDK 的销售总额约为 91 亿美元，全球雇员 80,000 人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。

请到本公司的新闻网站下载本新闻稿和相关图片

http://www.tdk.co.jp/news_center_c/press/20140212772.htm.

如欲获取更多有关本产品资料请点击 http://www.tdk.co.jp/tcfx01/sesub-pan-t2541_zh.pdf.

地区媒体联系方式

地域	负责人	所属	电话号码	邮件地址
Greater China	Ms. Clover XU	TDK China Co., Ltd.	+86 21 61962307	pr@cn.tdk.com